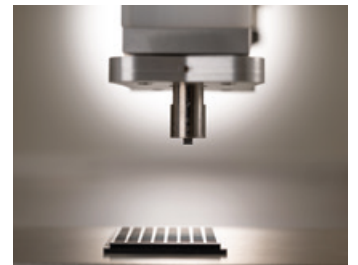
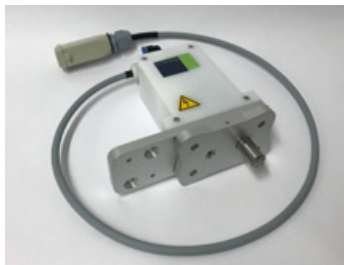
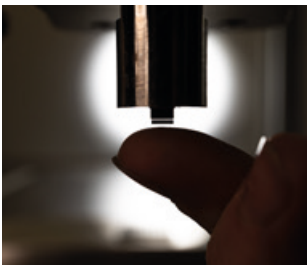


# MicroLevi-Greifer



## BERÜHRUNGSLOSES OBERSEITEN-GREIFEN UND -ABLEGEN VON KLEINTEILEN

Mit dem MicroLevi-Greifer können sensible Materialien kontaktlos von oben angehoben und abgelegt werden. Eingesetzt wird er bei der Handhabung kleiner Werkstücke, wie z.B. kleine Folien und Gläser, Dies, Chips und weitere Kleinteile.



Durch eine Kombination aus Unterdruck und Ultraschall wirken gleichzeitig anziehende und abstoßende Kräfte auf das Werkstück und halten es somit auch beim Greifen von oben auf Abstand. Dadurch können keine Verunreinigungen oder Mikrokratzer auf dem Kleinteil entstehen.

Der MicroLevi-Greifer kann mit Spitzen unterschiedlicher Größe kombiniert werden. Aufgrund der kleinen Maße ist die Selbstzentrierung der Werkstücke gewährleistet, sodass keine unterstützenden Randanschläge benötigt werden und hochpräzise positioniert werden kann. Außerdem kann der Greifer seitlich gefahren sowie geschwenkt werden.

### Merkmale des MicroLevi-Greifers:

- Berührungsloses Oberseitengreifen
- Selbstzentrierung des Werkstücks
- Hochpräzises Greifen und Ablegen
- Keine Mikrokratzer oder andere Beschädigungen
- Keine Partikel, da keine Luftverwirbelungen
- Geringer Energieverbrauch

### Einsatzmöglichkeiten



[zs-handling.com](https://www.zs-handling.com)

### Kontakt und Vertrieb:

ZS-Handling GmbH  
Budapester Straße 2  
93055 Regensburg

Telefon: +49 941 60389-900  
Fax: +49 941 60389-999  
Mail: [sales@zs-handling.de](mailto:sales@zs-handling.de)

Weitere Informationen erhalten Sie mit  
nebenstehendem QR-Code oder unter  
<https://www.zs-handling.com>



Innovative Technologie:

# Das Ultraschallager



Unsere Handhabungssysteme nutzen das Ultraschallager für die Applikation der Handhabungskräfte auf das Werkstück und können in allen atmosphärischen Prozessen eingesetzt werden.

Schwingungserzeuger mit getrennter Leistungselektronik erzeugen einen verdichteten Luftfilm mit abstoßenden Kräften. Verfahrenskombinationen ermöglichen die Erzeugung anziehender Kräfte.

Die umgebende Luft oder das Prozessgas wird durch den Ultraschall verdichtet. Somit können Bauteile angehoben und kontaktfrei entlang definierter Bahnen geführt werden. In Kombination mit Unterdruck können Werkstücke auch an der Oberseite gegriffen werden - ohne sie zu berühren.

Das Ultraschallager benötigt weniger Energie als andere berührungslose Handhabungstechnologien.

## **Wir bei ZS-Handling haben eine Mission:**

*unsere Kunden in die Lage zu versetzen,  
sensible Produkte in der Produktion und zu Testzwecken  
berührungslos zu handhaben.*

## **Wir lassen Teile schweben.**

*Seit 2006 entwickeln, produzieren und vertreiben wir  
Komponenten und Spezialmaschinen für Anwender  
in Europa, Nordamerika und Asien.*

## Unsere Produkte

LeviSolar-Greifer  
LeviWafer-Greifer  
MicroLevi-Greifer  
ManuLevi-Greifer  
OptoMicroMed-Greifer  
RobotOverhead-Greifer  
UltraLevi-Chuck  
UltraLevi-Tisch  
LinearLevi-Förderer  
LinearOverhead-Transport-System  
LinearLevi-Inspektions-Modul  
Modulares Waferhandling-System  
Levi-Roll

## Anwendungen



- Batterie- und Brennstoffzellen
- Folien
- Glas
- Linsen
- Medizintechnik
- Verpackung
- Wafer & Chips

## Prozesse



- Be- und Entladen
- Fördern
- Greifen
- Inspizieren
- Sortieren
- Vereinzeln